

红外编码/解码器

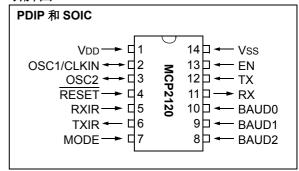
特性

- 支持 IrDA® 物理层规范 (版本 1.3)
- UART 到 IR 编码 / 解码器
 - 与兼容 IrDA 标准的收发器连接
 - 可与任何 UART 一起使用,包括标准 16550 UART 和单片机内置的 UART 模块
- 支持的发送/接收模式:
 - 1.63 µs
- 硬件或软件波特率选择
 - 最高可工作在 IrDA 标准 115.2k 波特率下
 - 采用 20 MHz 时钟时,最高工作速率为 312.5k 波特率
 - 低功耗模式
- 无铅封装

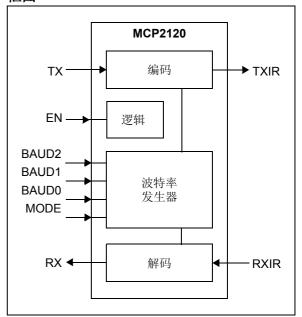
CMOS 技术

- · 低功耗而高速的 CMOS 技术
- 完全静态设计
- 低电压运行
- 商业级和工业级温度范围
- 低功耗
 - 3.3V, 8 MHz 时 < 1 mA (典型值)
 - 5.0V,被禁止时为 3 mA (典型值)

引脚图



框图



注:

1.0 器件概述

本文档包含下列器件的特定信息:

MCP2120

MCP2120 为低成本而高性能的全静态红外编码 / 解码器。该器件位于 UART 和红外 (IR) 光学收发器之间。

从标准 UART 接收的数据被编码(调制),以电脉冲的形式输出到 IR 收发器。IR 收发器接收到的数据同样也是以电脉冲的形式输出的。MCP2120 解码(解调)这些电脉冲,并通过 MCP2120 的 UART 进行传送。这种调制和解调方式遵照 IrDA 标准进行。

通常选择单片机同 IR 编码 / 解码器接口。

红外通信是一种使用红外线技术的无线双向数据连接方式。依靠低成本的收发器信号传递技术产生红外线,为两个设备之间提供可靠的通信。

红外技术提供了:

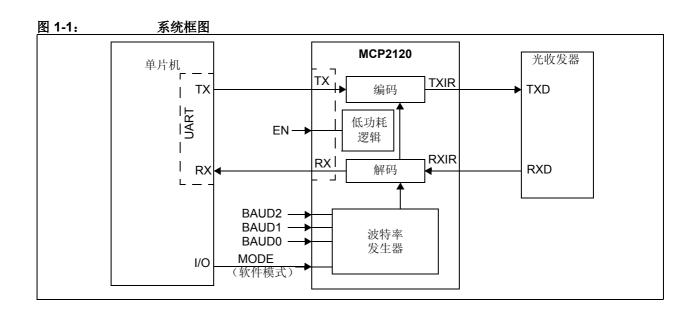
- 用于连接便携式计算设备的通用标准
- 简单易行的实现方式
- 与其他连接方案相比,是较经济的选择
- 可靠而高速的连接
- 能在任何环境下安全使用(甚至可在航空旅行时使用)
- 省却了电缆的麻烦
- 允许 PC 间、其他电子设备间以及 PC 与其他电子 设备的通信
- 连接方便从而提高了移动性

1.1 应用

MCP2120 为独立式 IrDA 编码 / 解码器产品。图 1-1 显示了典型的应用框图;表 1-2 给出了 用户(正常)工作模式下的引脚定义。

表 1-1: MCP2120 特性概述

特性	MCP2120
串行通信:	UART 和 IR
波特率选择:	硬件/软件
低功耗模式:	有
复位 (及延迟):	唤醒 (DRT)
封装:	14 引脚 DIP 14 引脚 SOIC



用户模式下的引脚说明 表 1-2:

引脚名称	引服	申号	引脚	缓冲器	
刀腳右你	PDIP	SOIC	类型	类型	说明
VDD	1	1	I	Р	逻辑和 I/O 引脚的正电源
OSC1/CLKIN	2	2	I	CMOS	振荡器晶振荡输入/外部时钟源输入
OSC2	3	3	0	_	振荡器晶振输出
RESET	4	4	I	ST	器件复位
RXIR	5	5	I	ST	从红外收发器异步接收
TXIR	6	6	0	_	异步发送到红外收发器
MODE	7	7	I	TTL	选择软件波特率工作模式 (数据 / 命令)。请参见 第 2.4.1.2 节 "软件选择" 获取更多信息。
BAUD2	8	8	I	TTL	BAUD2:BAUD0 指定器件的波特率,或器件是否工作在软件波特
BAUD1	9	9	I	TTL]率模式。请参见 第 2.4.1 节 "波特率" 获取更多信息。
BAUD0	10	10	I	TTL	
RX	11	11	0	_	异步发送到控制器 UART
TX	12	12	1	TTL	从控制器 UART 异步接收
EN	13	13	I	_	器件使能
Vss	14	14	_	Р	逻辑和 I/O 引脚的参考地

ST = 带有 CMOS 电平的施密特触发器输入

图注: TTL = TTL 兼容输入

|= 输入

P = 电源

CMOS = CMOS 兼容输入

O = 输出

2.0 器件操作

MCP2120 为低成本红外编码 / 解码器。用户可在9600 波特率至 115.2k 波特率的标准 IrDA 波特率范围内进行选择。最大波特率为 312.5k。

2.1 上电

只要器件上电,就会发生器件复位定时器延时(参数 32)。一旦这些延时结束,就可开始与器件通信。通信可由红外收发器和控制器 UART 接口两者中的任一个发起。

2.2 器件复位

当 RESET 引脚为低电平状态时,MCP2120 被迫进入 复位状态。一旦 RESET 引脚变为高电平,器件复位定 时器就会启动。DRT 定时一旦结束,器件就开始正常操 作。

2.3 位时钟

器件晶振用于产生通信位时钟(BITCLK)。每个位时间有 16 个 BITCLK。BITCLK 用于产生起始位和 8 个数据位。当数据发送结束后(不用于数据接收),停止位使用 BITCLK。

此时钟采用固定频率且频率漂移很小(由晶振生产商规定)。

2.4 UART 接口

UART 接口用于与"控制器"进行通信。这个接口是半双工接口,即系统或进行发送或进行接收,但两者不能同时进行。

2.4.1 波特率

MCP2120 的波特率可通过三个硬件引脚(BAUD2、BAUD1 和 BAUD0)的状态或通过软件选择来配置。

2.4.1.1 硬件选择

三个器件引脚用来选择 MCP2120 发送和接收数据的波特率。这些引脚为 BAUD2,BAUD1 和 BAUD0。应用软件也可通过设置一个引脚的状态(器件模式)来指定波特率。表 2-1 显示了波特率配置。

表 2-1: 硬件波特率选择与频率对照表

		频率(MHz)							
BAUD2:BAUD0	0.6144 ⁽¹⁾	2.000	3.6864	4.9152	7.3728	14.7456 ⁽²⁾	20.000 ⁽²⁾	比特率	
000	800	2604	4800	6400	9600	19200	26042	Fosc / 768	
001	1600	5208	9600	12800	19200	38400	52083	Fosc / 384	
010	3200	10417	19200	25600	38400	78600	104167	Fosc / 192	
011	4800	15625	28800	38400	57600	115200	156250	Fosc / 128	
100	9600	31250	57600	78600	115200	230400	312500	Fosc / 64	

注 1: 频率低于 2 MHz 时,推荐使用外部时钟源。

2: 若频率高于 7.5 MHz, TXIR 脉冲宽度 (参数 IR121) 应比 IrDA 标准规范中的最小脉冲宽度 1.6 μs 短。

2.4.1.2 软件选择

当 BAUD2:BAUD0 引脚配置为 "111"时, MCP2120 的默认波特率为 Fosc / 768。

若需 MCP2120 处于命令模式,则需将 MODE 引脚连接到低电平。在命令模式下,MCP2120 UART 接收到的任何数据都被返回给控制器,而不进行编码 / 解码。回波数据的延时短于 1 个位时间(见参数 IR141)。当 MODE 引脚变为高电平时,器件将返回到数据模式,其编码 / 解码器处于正常工作状态。

表 2-2 显示了配置 MCP2120 波特率的软件 hex 命令。

MCP2120 以现有的波特率接收数据字节。当接收到改变波特率命令(0x11)时,最后接收到的有效波特率值变为新的波特率。新的波特率在回波数据的停止位之后有效。图 2-2 显示了这一时序。

2.4.2 发送

当控制器发送串行数据到 MCP2120 时,要求波特率相 互匹配。

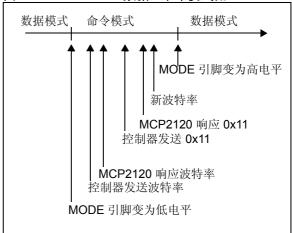
检测到起始位的下降沿存在一些抖动。这种抖动将影响编码后起始位的位置。所有后续位将延时16 BITCLK时间才会出现。

2.4.3 接收

当控制器从 MCP2120 接收串行数据时,要求波特率相互匹配。

检测到起始位的下降沿存在一些抖动。这种抖动将影响解码后起始位的位置。所有后续位将延时16 BITCLK时间才会出现。

图 2-1: 数据 / 命令模式流



当响应数据时,一旦检测到第一位,就将其返回, 这意味着回波数据的延时少于 1 个位时间。

一旦回波数据的停止位结束,新波特率就将有效。

表 2-2:	软件波特率选择与频率对照表
/X Z=Z:	4/\ IT //\ 4\T\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Hex		频率(MHz)							
命令 (3, 4)	0.6144 ⁽¹⁾	2.000	3.6864	4.9152	7.3728	14.7456 ⁽²⁾	20.000 ⁽²⁾	比特率	
0x87	800	2604	4800	6400	9600	19200	26042	Fosc / 768	
0x8B	1600	5208	9600	12800	19200	38400	52083	Fosc / 384	
0x85	3200	10417	19200	25600	38400	78600	104167	Fosc / 192	
0x83	4800	15625	28800	38400	57600	115200	156250	Fosc / 128	
0x81	9600	31250	57600	78600	115200	230400	312500	Fosc / 64	

- 注 1: 频率低于 2 MHz 时,推荐使用外部时钟源。
 - **2:** 若频率高于 7.3728 MHz, TXIR 脉冲宽度 (参数 IR121) 应比 IrDA 标准规范中的最小脉冲宽度 1.6 μs 每 .
 - 3: 命令 0x11 用于改变到新波特率。
 - 4: 其他命令代码保留,将来可能会用到。

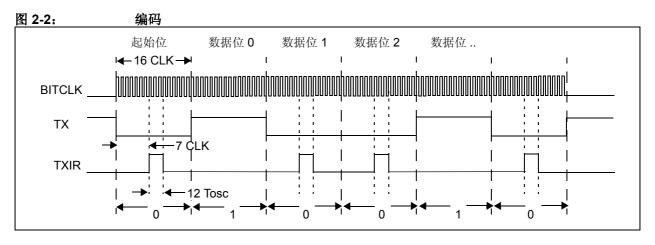
2.5 调制

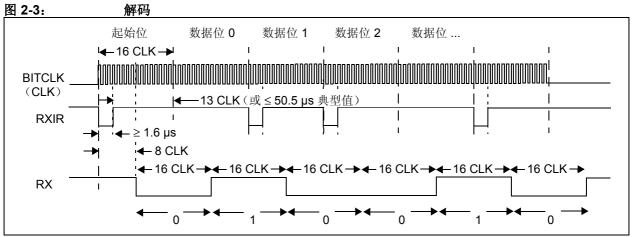
UART 接收到的要被发送的数据需要被调制。此调制信号驱动 IR 收发器模块。图2-2显示了调制信号的编码。每个位时间由 16 个位时钟组成。如果要发送的值(由TX 引脚决定)为逻辑低电平,则 TXIR 引脚将输出 7 个位时钟周期的低电平,3 个位时钟周期的高电平,其余6 个位时钟周期将为低电平。如果要发送的值为逻辑高电平,则 TXIR 引脚将在整个 16 个位时钟周期内输出低电平。

2.6 解调

来自 IR 收发器模块的调制信号需要被解调以形成接收数据。一旦发生了数据字节的解调,接收数据就会由RX 引脚以 UART 格式逐位进入。图 2-3 显示了调制信号的解调。

每个位时间由 16 个位时钟组成。如果要接收的值为逻辑低电平,则 RXIR 引脚将先输出 3 个位时钟周期的低电平,其余 13 个位时钟周期将为高电平。如果被接收的值为逻辑高电平,则 RXIR 引脚将在整个 16 个位时钟周期内输出高电平。RX 引脚的电平在整个 16 个位时钟周期内的状态与之对应。





2.7 编码 / 解码抖动和偏移

图 2-4 显示了 RX 引脚和 TXIR 引脚上可能的抖动和偏移。

抖动是相对于理想边沿可能出现的变化。

偏移为输入信号(RXIR 或 TX)至输出信号(RX 或 TXIR)的传输延迟。

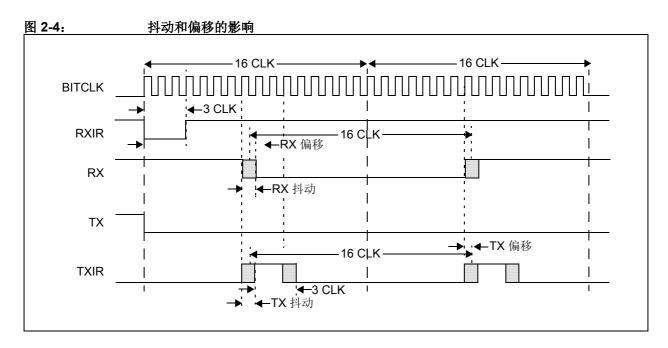
输出引脚(RX 或 TXIR)的第一位显示相对于输入引脚(RXIR 或 TX)的抖动,但所有剩余位仍保持恒定间距。

2.8 最大限度减小功耗

通过禁止器件(保持 EN 引脚为低电平状态)可使器件进入低功耗模式。内部状态机监视该引脚是否为低电平,一旦检测到低电平,器件就将被禁止并进入低功耗状态。

2.8.1 返回工作状态

当器件被禁止时,器件处于低功耗模式。当 EN 引脚被拉回高电平时,器件将返回工作模式。之后,需要经过1000 Tosc 的延时,数据才可以被发送或接收。



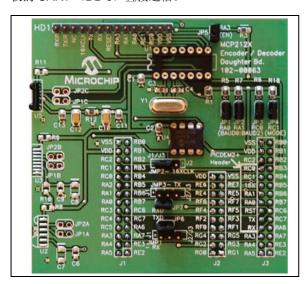
3.0 开发工具

MCP212X 开发工具子板用于评估和演示 MCP2122 或 MCP2120 IrDA[®] 标准编码 / 解码器件。

MCP212X 开发工具子板上的接头使之可以很容易得与系统相连进行开发。

MCP212X 开发工具子板设计成可以连接到某些新型的低成本 PIC[®] 演示板。这些演示板包括 PICDEM HPC Explorer 演示板、PICDEM FS USB 演示板和 PICDEM LCD 演示板。

当 MCP212X 开发工具子板与 PICDEM HPC Explorer 演示板配套使用时,MCP212x可以连接到 PIC18F8772 的两个 UART 中的任一个;或者将 RX 和 TX 信号"交叉",使 MCP212x 器件与 PICDEM HPC Explorer 演示板的 UART(DB-9)直接通信。



特性:

- 8 引脚的插座用于安装 MCP2122 (预先安装), 14 引脚插座用于安装 MCP2120
- 三个光收发器电路(1个已安装)
- 连接到低成本 PICDEM 演示板的接头,这些演示板包括:
 - • PICDEM™ HPC Explorer 演示板
 - • PICDEM™ LCD 演示板
 - • PICDEM™ FS USB 演示板
 - • PICDEM™ 2 Plus 演示板
- 方便连接到用户嵌入式系统的接头
- 可使用跳线选择 MCP212X 信号接入 PICDEM™ 演示板插头的路径
- 配置演示板工作模式的跳线

MCP2120/MCP2150 开发工具套件已不再提供,若能 找到这些套件,可用它来演示 MCP2120 的工作过程。

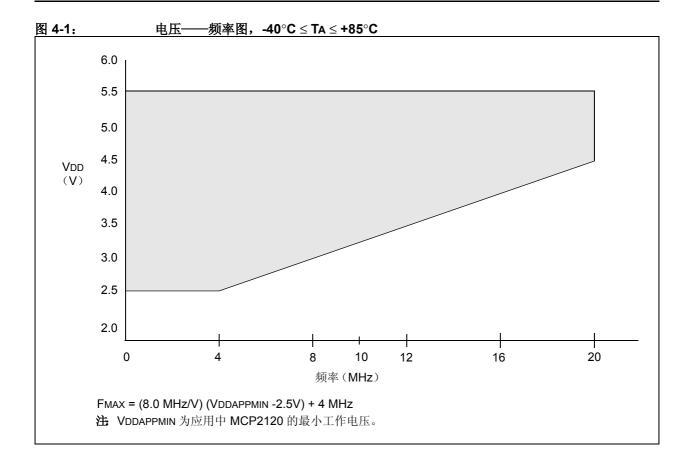
注:

4.0 电气特性

绝对最大值 †

偏置条件下的环境温度	40°C 至 +125°C
存储温度	65°C 至 +150°C
VDD 相对于 Vss 的电压	0至+7V
RESET 相对于 Vss 的电压	0 至 +14V
所有其他引脚相对于 Vss 的电压	0.6V 至(VDD + 0.6V)
总功耗 ⁽¹⁾	700 mW
从 Vss 引脚流出的最大电流	150 mA
流入 VDD 引脚的最大电流	125 mA
输入钳位电流 IIK (VI < 0 或 VI > VDD)	
输出钳位电流 loк (V0 < 0 或 V0 > VDD)	±20 mA
任一输出引脚的最大灌电流	25 mA
任一输出引脚的最大拉电流	25 mA
注 1: 功耗计算如下: PDIS = VDD x {IDD - Σ IOH} + Σ {(VDD-VOH) x IOH} + Σ (VOL x IOL)	

†注:如果器件的工作条件超过"绝对最大值"列出的范围,就可能会对器件造成永久性损坏。上述值仅为运行条件极大值,我们建议不要使器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大额定值条件下,其稳定性会受到影响。



4.1 直流特性

直流特性	•		标准工作条件 (除非另有说明) 工作温度: —40°C ≤ Ta ≤ +85°C (工业级)					
参数 编码	符号	特性	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件	
D001	VDD	供电电压	2.5	_	5.5	V	见图 4-1	
D002	VDR	RAM 数据保持电压 (2)	2.5	_	_	V	器件振荡器/时钟停止	
D003	VPOR	保证上电复位的 VDD 启动电压	_	Vss	_	V		
D004	SVDD	保证上电复位的 VDD 上升速率	0.05	_	_	V/ms		
D010	IDD	供电电流 (3)		0.8 0.6 0.4 3 4	1.4 1.0 0.8 7 12 16	mA mA mA mA mA	Fosc = 4 MHz, VDD = 5.5V Fosc = 4 MHz, VDD = 3.0V Fosc = 4 MHz, VDD = 2.5V Fosc = 10 MHz, VDD = 3.0V Fosc = 20 MHz, VDD = 4.5V Fosc = 20 MHz, VDD = 5.5V	
D020	IPD	器件禁止时的电流 (3, 4)		0.25 0.25 0.4 3	4 3 5.5 8	μΑ μΑ μΑ μΑ	$\begin{split} \text{VDD} &= 3.0 \text{V}, 0^{\circ}\text{C} \leq \text{TA} \leq +70^{\circ}\text{C} \\ \text{VDD} &= 2.5 \text{V}, 0^{\circ}\text{C} \leq \text{TA} \leq +70^{\circ}\text{C} \\ \text{VDD} &= 4.5 \text{V}, 0^{\circ}\text{C} \leq \text{TA} \leq +70^{\circ}\text{C} \\ \text{VDD} &= 5.5 \text{V}, -40^{\circ}\text{C} \leq \text{TA} \leq +85^{\circ}\text{C} \end{split}$	

- 注 1: "典型值"一列中的数据是在 +25℃ 时测得的。此数据未经测试,仅供设计参考。
 - 2: 这是在不丢失 RAM 数据的前提下 VDD 可降到的极限值。
 - 3: 供电电流主要是工作电压和频率的函数。引脚负载和开关频率以及温度都对电流消耗有影响。
 - a) 器件使能 (EN 引脚为高电平) 时,所有 IDD 测量的测试条件如下: OSC1 = 外部方波,满幅; 所有输入引脚拉至 VSS,RXIR = VDD, RESET = VDD;
 - b) 禁止器件 (EN 引脚为低电平)时,电流测量的条件相同。
 - **4:** 禁止器件 (EN 引脚为低电平)时,电流的测量条件如下: 所有输入引脚均连接到 VDD 或 Vss, 且将输出引脚驱动为高电平或低电平直至无穷阻抗。

直流特性 (续)

直流特性			工作温度:	标准工作条件 (除非另有说明) 工作温度: -40°C≤Ta≤+85°C (工业级) VDD 工作电压范围如 第 4.1 节 "直流特性" 中的直流规范所述。					
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件		
		输入低电压							
	VIL	输入引脚							
D030		带 TTL 缓冲器	Vss	_	0.8V	V	$4.5 \le VDD \le 5.5V$		
D030A			Vss	_	0.15VDD	V	其他情况		
D031		带施密特触发缓冲器	Vss	_	0.2VDD	V			
D032		RESET 和 RXIR	Vss	_	0.2VDD	V			
D033		OSC1	Vss	_	0.3VDD	V			
		输入高电压							
	VIH	输入引脚		_					
D040		带 TTL 缓冲器	2.0	_	VDD	V	$4.5 \le VDD \le 5.5V$		
D040A			0.25VDD + 0.8VDD	_	VDD	V	其他情况		
D041		带施密特触发缓冲器	0.8VDD	_	VDD	V	适用于整个 VDD 范围		
D042		RESET 和 RXIR	0.8VDD	_	VDD	V			
D043		OSC1	0.7VDD	_	VDD	V			
		输入泄漏电流 (1, 2)							
D060	lıL	输入引脚	_	_	±1	μΑ	Vss≤Vpin≤Vdd,引脚处于高阻 态		
D061		RESET	_	_	±30	μΑ	Vss ≤ Vpin ≤ Vdd		
D063		OSC1	_	_	±5	μΑ	Vss ≤ Vpin ≤ Vdd,XT、 HS 和 LP 振荡器配置		
D070	lpur	弱上拉电流	50	250	400	μA	VDD = 5V 和 VPIN = Vss		

注 1: RESET 引脚上的泄漏电流主要取决于所施加的电压。规定电平表示正常工作条件下的电平。在输入电压不同时可能测得更大的泄漏电流。

^{2:} 负电流定义为从引脚流出的电流。

直流特性 (续)

直流特性	i.		标准工作条件 (除非另有说明) 工作温度: —40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) VDD 工作电压范围如 第 4.1 节 "直流特性" 中的直流规范所述。					
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值 (1)	最大值	单位	条件	
D080	Vol	输出低电压 TXIR 和 RX	_	_	0.6	٧	IOL = 8.5 mA,VDD = 4.5V, -40°C 至 +85°C	
D083		OSC2	_	_	0.6	V	IOL = 1.6 mA,VDD = 4.5V, –40°C 至 +85°C	
D090	Vон	输出高电压 TXIR 和 RX ⁽¹⁾	VDD - 0.7	_	_	٧	IOH = -3.0 mA, VDD = 4.5V, -40°C 至 +85°C	
D092		OSC2	VDD - 0.7	_	_	V	IOH = -1.3 mA,VDD = 4.5V, –40°C 至 +85°C	
		输出引脚上的容性负载 规范						
D100 D101	Cosc2 Cio	OSC2 引脚 所有输入或输出引脚	<u> </u>	_ _	15 50	pF pF	使用外部时钟驱动 OSC1 时。	

注 1: 负电流定义为从引脚流出的电流。

4.2 时序参数符号和负载条件

时序参数符号按照以下某种格式创建:

4.2.1 时序条件

除非另有说明,否则表 4-2 中指定的温度和电压适用于所有时序规范。图 4-2 规定了时序规范的负载条件。

表 4-1: 符号

1. TppS2ppS

ppc=p	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u> </u>	
T F E	频率 误差	Т	时间
小写字母	(pp) 及其含义:		
рр			
io	输入或输出引脚	osc	振荡器
rx	接收	tx	发送
bitclk	RX/TX BITCLK	RST	复位
drt	器件复位定时器		
大写字母及	及其含义:		
S			
F	下降	Р	周期
Н	高电平	R	上升
1	无效 (高阻态)	V	有效
L	低电平	Z	高阻态

2. TppS

表 4-2: 交流温度和电压规范

	标准工作条件 (除非另有说明)	
交流特性	工作温度: -40°C≤T A≤+85°C (工业级)	
	VDD 工作电压范围如 第 4.1 节 "直流特性" 中的直流规范所述。	

图 4-2: 器件时序规范的负载条件



4.3 时序图和规范



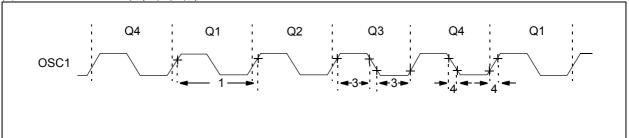
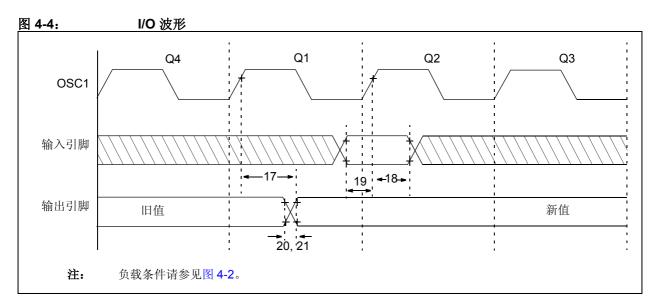


表 4-3: 外部时钟时序要求

交流特性	Ē		标准工作条件 (除非另有说明) 工作温度: —40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) VDD 工作电压范围如 第 4.1 节 "直流特性" 所述。					
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值 (1)	最大值	单位	条件	
1	Tosc	外部 CLKIN 周期 ^(2,3)	50	_		ns		
		振荡器周期 (2)	50	_	500	ns		
1A	Fosc	外部 CLKIN 频率 ^(2,3)	DC		20	MHz		
		振荡器频率 (2)	2	_	20	MHz		
1C	Eclk	时钟误差	_	_	0.01	%		
3	TosL, TosH	OSC1上输入时钟信号的高电 平或低电平时间	10	_		ns		
4	TosR, TosF	OSC1上输入时钟信号的上升或下降时间	_		15	ns		

- 注 1: 除非另有说明,否则"典型值"一列中的数据均在 5V、+25°C 条件下测得。此数据未经测试,仅供设计参考。
 - **2:** 所有值均为在特定的振荡器模式下,器件在标准工作条件下执行代码时获得的特征数据。超出规定值可能导致振荡器运行不稳定和/或电流消耗超出预期值。 当使用外部时钟输入时,所有器件的"最大"周期时间限制为"直流"(没有时钟)。
 - 3: 采用外部时钟时,建议占空比不超过60/40 (高电平时间/低电平时间或低电平时间/高电平时间)。



交流特性			工作温度	条件 (除非 : :电压范围如	-40	$0^{\circ}C \leq TA \leq$	≤+85℃ (工业级) 5性" 所述。
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值 (1)	最大值	单位	条件
17	TosH2ioV	OSC1 [↑] (Q1 周期) 至输出 有效的时间 ⁽²⁾	_		100	ns	
18	TosH2ioI	OSC1↑ (Q2 周期) 至输入 无效的时间 (I/O 保持时间)	200			ns	
19	TioV2osH	输入有效至 OSC1↑的时间 (I/O 建立时间)	0	_	_	ns	
20	ToR	RX 和 TXIR 引脚上升时间 (2)	_	10	25	ns	
21	ToF	RX 和 TXIR 引脚下降时间 (2)	_	10	25	ns	

注 1: 除非另有说明,否则"典型值"一列中的数据均在 5V、+25°C 条件下测得。

^{2:} 负载条件请参见图 4-2。

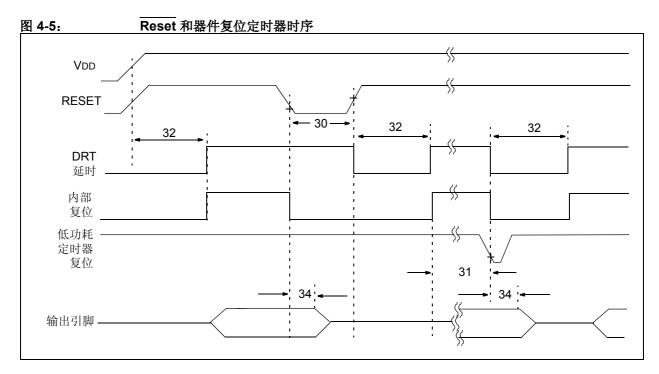


表 4-5: RESET 和器件复位定时器要求

交流特性	<u>:</u>		标准工作条 位工作温度:		–40°C	_	5°C (工业级) ' 所述。
参数 编号	符号	特性	最小值 典型值 (1) 最大值 单位 条件				
30	TrstL	RESET 脉冲宽度 (低电平)	2000	_	_	ns	V _{DD} = 5.0 V
31	TLPT	低功耗延时周期	9	18	30	ms	VDD = 5.0 V
32	TDRT	器件复位定时器周期	9	18	30	ms	V _{DD} = 5.0 V
34	Tioz	从 RESET 为低电平或器件复位至输出呈现高阻态的时间	_	_	2	μs	

注 1:除非另有说明,否则"典型值"一列中的数据均在5V、+25°C条件下测得。

图 4-6: USART 异步发送波形 | 起始位 数据位 数据位 数据位 数据位 | IR100 → IR103 → IR103 → IR103 → IR103

表 4-6: USART 异步发送要求

交流特性	±		标准工作条件 (除非另有说明) 工作温度: -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) VDD 工作电压范围如 第 4.1 节 "直流特性" 所述。					
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值 (1)	最大值	单位	条件	
IR100	Ттхвіт	发送波特率					硬件选择	
			768	_	768	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 000	
			384	_	384	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 001	
			192	_	192	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 010	
			128	_	128	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 011	
			64		64	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 100	
							软件选择 BAUD2:BAUD0 = 111	
			768	_	768	Tosc	Hex 命令 = 0x87	
			384	_	384	Tosc	Hex 命令 = 0x8B	
			192	_	192	Tosc	Hex 命令 = 0x85	
			128	_	128	Tosc	Hex 命令 = 0x83	
			64	_	64	Tosc	Hex 命令 = 0x81	
IR101	Етхвіт	发送(TX 引脚)波特率误差 (发送到 MCP2120)	_	_	1	%		
IR102	ETXIRBIT	发送(TXIR 引脚)波特率误差(从 MCP2120 输出) ⁽¹⁾	_	_	1	%		
IR103	TTXRF	TX 引脚上升和下降时间	_	_	25	ns		

注 1: 此误差没有加到参数 IR101 上。

图 4-7: USART 异步接收时序 起始位 数据位 数据位 数据位 IR110 → IR110 → IR110 → IR110 → IR110 → IR110 → IR112 注: 负载条件请参见图 4-2。

表 4-7: USART 异步接收要求

交流特性	Ė		标准工作条件 (除非另有说明) 工作温度: -40°C ≤ Ta ≤ +85°C (工业级) VDD 工作电压范围如 第 4.1 节 "直流特性" 所述。						
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值 (1)	最大值	单位	条件		
IR110	TRXBIT	接收波特率					硬件选择		
			768	_	768	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 000		
			384	_	384	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 001		
			192	_	192	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 010		
			128	_	128	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 011		
			64	_	64	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 100		
							软件选择 BAUD2:BAUD0 = 111		
			768	_	768	Tosc	Hex 命令 = 0x87		
			384	_	384	Tosc	Hex 命令 = 0x8B		
			192	_	192	Tosc	Hex 命令 = 0x85		
			128	_	128	Tosc	Hex 命令 = 0x83		
			64	_	64	Tosc	Hex 命令 = 0x81		
IR111	ERXBIT	接收 (RXIR 引脚) 波特率 误差 (从 MCP2120 输出)	_	_	1	%			
IR112	ERXBIT	接收(RX 引脚)波特率误差(从 MCP2120 输出) ⁽¹⁾		_	1	%			
IR113	TTXRF	RX 引脚上升和下降时间			25	ns			

注 1: 此误差没有加到参数 IR111 上。

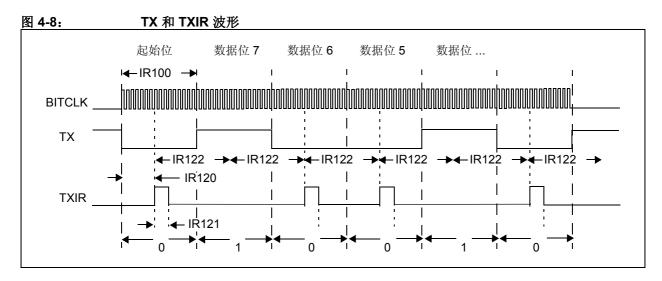


表 4-8: TX 和 TXIR 要求

交流特性	Ė		标准工作条件 (除非另有说明) 工作温度: —40°C≤Ta≤+85°C (工业级) VDD 工作电压范围如 第 4.1 节 "直流特性" 所述。						
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值 (1)	最大值	单位	条件		
IR100	Ттхвіт	发送波特率					硬件选择		
			768	_	768	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 000		
			384	_	384	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 001		
			192	_	192	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 010		
			128	_	128	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 011		
			64	_	64	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 100		
					8		软件选择 BAUD2:BAUD0 = 111		
			768	_	768	Tosc	Hex 命令 = 0x87		
			384	_	384	Tosc	Hex 命令 = 0x8B		
			192	_	192	Tosc	Hex 命令 = 0x85		
			128	_	128	Tosc	Hex 命令 = 0x83		
			64	_	64	Tosc	Hex 命令 = 0x81		
IR120	TTXL2TXIRH	TX 下降沿 (↓) 至	7TBITCLK	7	7TBITCLK	TBITCLK			
		TXIR 上升沿 ([↑]) 的时 间 ⁽¹⁾	- 8.34 µs		+ 8.34 µs				
IR121	TTXIRPW	TXIR 脉冲宽度	12		12	Tosc			
IR122	TTXIRP	TXIR 位周期 ⁽¹⁾	_	16	_	TBITCLK			

注 1: TBITCLK = TTXBIT/16

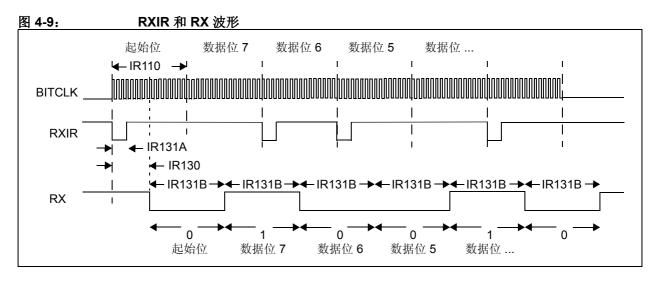


表 4-9: RXIR 要求

交流特性	Ė		标准工作条 工作温度: VDD 工作电	件 (除非另 !压范围如 第	–40°C ≤		°C (工业级) 所述。
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值 (1)	最大值	单位	条件
IR110	TRXBIT	接收波特率					硬件选择
			768		768	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 000
			384		384	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 001
			192		192	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 010
			128		128	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 011
			64		64	Tosc	BAUD2:BAUD0 = 100
							软件选择 BAUD2:BAUD0 = 111
			768	_	768	Tosc	Hex 命令 = 0x87
			384	_	384	Tosc	Hex 命令 = 0x8B
			192		192	Tosc	Hex 命令 = 0x85
			128		128	Tosc	Hex 命令 = 0x83
			64		64	Tosc	Hex 命令 = 0x81
IR130	TRXIRL2RXH	RXIR 下降沿(↓)至 RX	8Твітськ	8	8Твітськ	TBITCLK	
		下降沿 (↓) 的时间 (1)	- 8.34 μs		+ 8.34 µs		
IR131A	TRXIRPW	RXIR 脉冲宽度	3	_	3	Tosc	
IR132	TRXIRP	RXIR 位周期 ⁽¹⁾	_	16	_	TBITCLK	

注 1: TBITCLK = TRXBIT/16

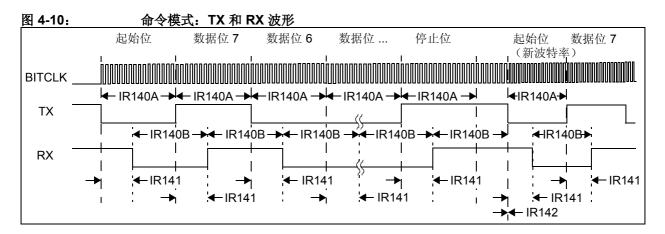


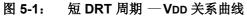
表 4-10: TX 和 TXIR 要求

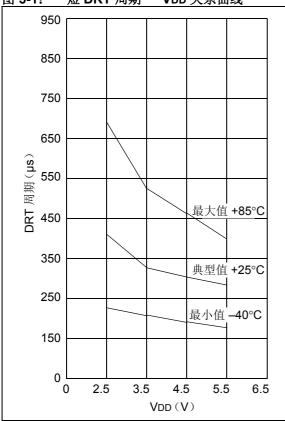
交流特性	:		工作温度:	条件(除非 。 电压范围如	-40°	$^{\circ}C \leq TA \leq$	+85°C (工业级) 性" 所述。
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值 (1)	最大值	单位	条件
IR140A	Втх	发送波特率	16	_	16	TBITCLK	
IR140B	Brx	接收波特率	16	_	16	TBITCLK	
IR141	TTXE2RXE	TX 边沿至 RX 边沿 (延时)	5.5	8	10.5	TBITCLK	
IR142	TrxP2txS	RX 停止位结束到 TX 起始位出现 (新波特率)的延时	_	_	0	Tosc	

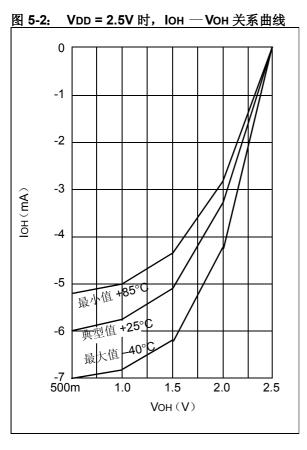
5.0 直流和交流特性图表

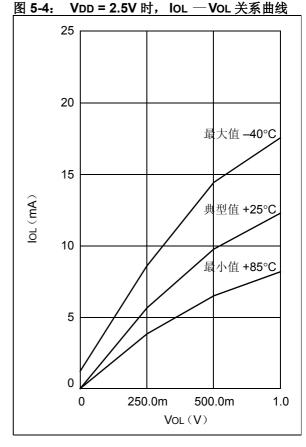
本节所提供的图表未经测试,仅供设计参考。在一些图表中,所列数据可能超出规定的工作范围(如,超出规定的 VDD 范围)。这些图表仅供参考,只有当各项参数满足规定条件时,器件才能够正常工作。

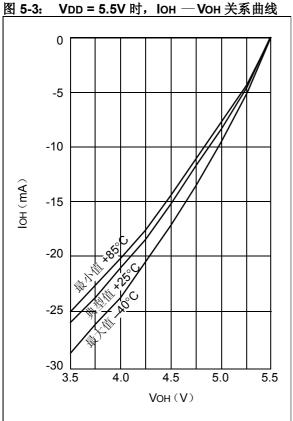
本节中的数据是在一定时间范围内不同批次器件相应参数值的统计结果。"典型值"表示平均值,而"最大值"或"最小值"分别表示为(平均值 + 3s)和(平均值 – 3s),其中 s 为标准偏差。

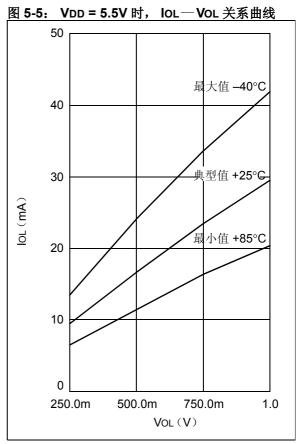








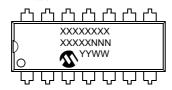




6.0 封装信息

6.1 封装标识信息

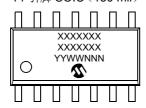




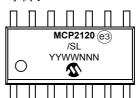
示例:



14 引脚 SOIC (150 mil)



示例:



图注: XX...X 客户指定信息

Y 年份代码 (公历年份的最后一位数字) YY 年份代码 (公历年份的最后两位数字)

WW 星期代码 (一月的第一个星期的代码为 "01")

 NNN
 以字母数字排序的追踪代码

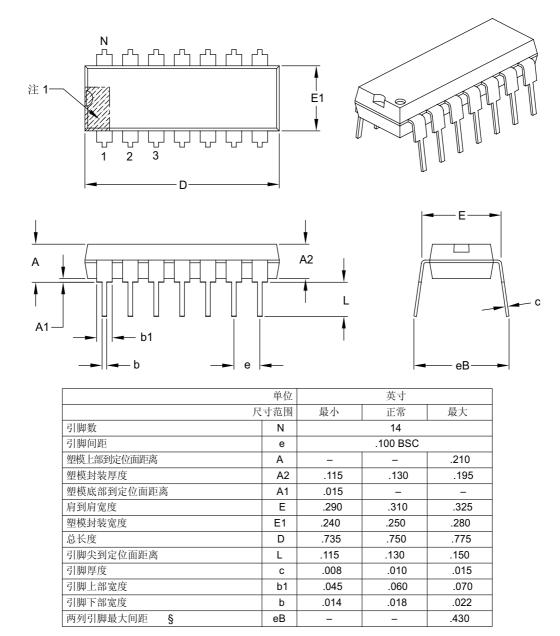
 (e3)
 雾锡(Sn)的 JEDEC 无铅标识

表示无铅封装。JEDEC 无铅标识(e3) 标示于此种封装的外包装上。

注: Microchip 元器件编号如果无法在同一行内完整标注,将换行标出,因此会限制客户指定信息的可用字符数。

14 引脚塑封双列直插式封装 (P) ——主体 300 mil[PDIP]

注: 最新的封装图,请至 http://www.microchip.com/packaging 查看 Microchip 封装规范。



注:

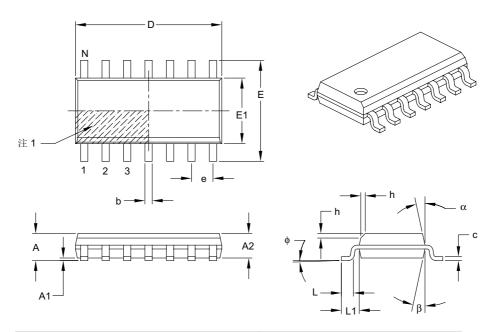
- 1. 引脚1定位特性可能有变化,但一定位于阴影区域内。
- 2. § 重要特性。
- 3. 尺寸D和E1不包括塑模毛边和突起。塑模每侧的毛边和突起不得超过0.010英寸。
- 4. 尺寸和公差遵循 ASME Y14.5M。

BSC: 基本尺寸。理论精确值,不包括公差。

Microchip Technology 图号 C04-005B

14 引脚塑封窄条小外形封装 (SL) ——主体 3.90 mm [SOIC]

注: 最新的封装图,请至 http://www.microchip.com/packaging 查看 Microchip 封装规范。



	单位		毫米		
	尺寸范围	最小	正常	最大	
引脚数	N		14		
引脚间距	е		1.27 BSC		
总高度	А	_	_	1.75	
塑模封装厚度	A2	1.25	_	-	
悬空间隙 §	A1	0.10	_	0.25	
总宽度	E	6.00 BSC			
塑模封装宽度	E1	3.90 BSC			
总长度	D	8.65 BSC			
塑模斜边投影距离 (可选)	h	0.25	_	0.50	
底脚长度	L	0.40	_	1.27	
引脚投影长度	L1		1.04 REF		
底脚倾角	ф	0°	_	8°	
引脚厚度	С	0.17	_	0.25	
引脚宽度	b	0.31	_	0.51	
塑模顶部倾角	α	5°	_	15°	
塑模底部倾角	β	5°	_	15°	

注:

- 1. 引脚1定位特性可能有变化,但一定位于阴影区域内。
- 2. § 重要特性。
- 3. 尺寸D和E1不包括塑模毛边和突起。塑模每侧的毛边和突起不得超过0.15 mm。
- 4. 尺寸和公差遵循 ASME Y14.5M。

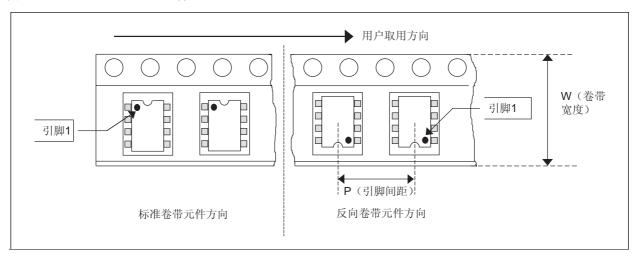
BSC: 基本尺寸。理论精确值,不包括公差。 REF: 参考尺寸。仅供参考,通常不包括公差。

Microchip Technology 图号 C04-065B

表 6-1: 卷带 / 腔尺寸

	外壳	封装			·带 .寸		卷带腔 尺寸		卷带 器件	卷带 直径
	类型	类型		W mm	P mm	A0 mm	B0 mm	K0 mm	数目	且任 mm
Ī	SL	SOIC .150"	14L	16	8	6.5	9.5	2.1	2600	330

图 6-2: SOIC 器件



附录 A: 版本历史

版本B (2007年2月)

- 更新开发工具部分
- 更新封装外形图
- 更新产品标识体系部分

版本A (2001年3月)

• 本数据手册的初始版本。

注:

产品标识体系

欲订货或获取价格、交货等信息,请与我公司生产厂或各销售办事处联系。

部件编号	X	/XX	示	例:	
 器件	 温度范围		a)		工业级温度, PDIP 封装
			b)	MCP2120-I/SL:	工业级温度, SOIC 封装
			c)	MCP2120T-I/SL:	卷带式,
器件	MCP2120 MCP2120	l: 红外编码/解码器 T: 红外编码/解码器,卷带式			工业级温度, SOIC 封装
温度范围	I = -4	.0 °C 至 +85 °C			
封装		4 引脚塑封 DIP (主体 300 mil) 4 引脚塑封 SOIC (主体 150 mil)			

注:

请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点:

- Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。
- Microchip 确信:在正常使用的情况下, Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。
- 目前,仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知,所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。
- Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。
- · Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是 "牢不可破"的。

代码保护功能处于持续发展中。 Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视为违反了 《数字器件千年版权法案 (Digital Millennium Copyright Act)》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下,能访问您的软件或其他受版权保护的成果,您有权依据该法案提起诉讼,从而制止这种行为。

提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含的英文部分,因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利,它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范,是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保,包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。Microchip 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命维持和/或生命安全应用,一切风险由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时,会维护和保障Microchip 免于承担法律责任,并加以赔偿。在 Microchip 知识产权保护下,不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

商标

Microchip 的名称和徽标组合、 Microchip 徽标、 Accuron、 dsPIC、KEELoQ、KEELoQ 徽标、 microID、 MPLAB、 PIC、 PICmicro、 PICSTART、 PRO MATE、 rfPIC 和 SmartShunt 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的 注册商标。

AmpLab、FilterLab、Linear Active Thermistor、Migratable Memory、MXDEV、MXLAB、SEEVAL、SmartSensor 和 The Embedded Control Solutions Company 均为 Microchip Technology Inc. 在美国的注册商标。

Analog-for-the-Digital Age、Application Maestro、CodeGuard、dsPICDEM、dsPICDEM.net、dsPICworks、dsSPEAK、ECAN、ECONOMONITOR、FanSense、FlexROM、fuzzyLAB、In-Circuit Serial Programming、ICSP、ICEPIC、Mindi、MiWi、MPASM、MPLAB Certified 徽标、MPLIB、MPLINK、PICkit、PICDEM、PICDEM.net、PICLAB、PICtail、PowerCal、PowerInfo、PowerMate、PowerTool、REAL ICE、rfLAB、Select Mode、Smart Serial、SmartTel、Total Endurance、UNI/O、WiperLock 和ZENA均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP 是 Microchip Technology Inc. 在美国的服务标记。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。

© 2007, Microchip Technology Inc. 版权所有。

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO/TS 16949:2002

Microchip 位于美国亚利桑那州 Chandler 和Tempe 与位于俄勒冈州 Gresham 的全球总部、设计和晶圆生产厂及位于美国加利福尼亚州和印度的设计中心均通过了ISO/TS-16949:2002 认证。公司在PIC® MCU 与dsPIC® DSC、KEELO® 跳码器件、串行 EEPROM、单片机外设、非易失性存储器和模拟产品方面的质量体系流程均符合 ISO/TS-16949:2002。此外,Microchip 在开发系统的设计和生产方面的质量体系也已通过了 ISO 9001:2000 认证。



全球销售及服务网点

美洲

公司总部 Corporate Office 2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224-6199 Tel: 1-480-792-7200 Fax: 1-480-792-7277

技术支持:

http://support.microchip.com 网址: www.microchip.com

亚特兰大 Atlanta Duluth GA

Tel: 678-957-9614 Fax: 678-957-1455

波士顿 Boston Westborough, MA

Tel: 1-774-760-0087 Fax: 1-774-760-0088

芝加哥 Chicago Itasca, IL

Tel: 1-630-285-0071 Fax: 1-630-285-0075

达拉斯 Dallas Addison, TX

Tel: 1-972-818-7423 Fax: 1-972-818-2924

底特律 Detroit

Farmington Hills, MI Tel: 1-248-538-2250 Fax: 1-248-538-2260

科科莫 Kokomo

Kokomo, IN Tel: 1-765-864-8360

Fax: 1-765-864-8387 洛杉矶 Los Angeles

Mission Viejo, CA Tel: 1-949-462-9523 Fax: 1-949-462-9608

圣克拉拉 Santa Clara

Santa Clara, CA Tel: 408-961-6444 Fax: 408-961-6445

加拿大多伦多 Toronto Mississauga, Ontario,

Canada

Tel: 1-905-673-0699 Fax: 1-905-673-6509

亚太地区

亚太总部 Asia Pacific Office

Suites 3707-14, 37th Floor Tower 6, The Gateway Harbour City, Kowloon Hona Kona

Tel: 852-2401-1200 Fax: 852-2401-3431

中国 - 北京

Tel: 86-10-8528-2100 Fax: 86-10-8528-2104

中国 - 成都

Tel: 86-28-8665-5511 Fax: 86-28-8665-7889

中国 - 福州

Tel: 86-591-8750-3506 Fax: 86-591-8750-3521

中国 - 香港特别行政区 Tel: 852-2401-1200 Fax: 852-2401-3431

中国-南京

Tel: 86-25-8473-2460 Fax: 86-25-8473-2470

中国-青岛

Tel: 86-532-8502-7355 Fax: 86-532-8502-7205

中国 - 上海

Tel: 86-21-5407-5533 Fax: 86-21-5407-5066

中国 - 沈阳

Tel: 86-24-2334-2829 Fax: 86-24-2334-2393

中国-深圳

Tel: 86-755-8203-2660 Fax: 86-755-8203-1760

中国 - 顺德 Tel: 86-757-2839-5507 Fax: 86-757-2839-5571

中国 - 武汉

Tel: 86-27-5980-5300 Fax: 86-27-5980-5118

中国-西安

Tel: 86-29-8833-7252 Fax: 86-29-8833-7256

台湾地区 - 高雄

Tel: 886-7-536-4818 Fax: 886-7-536-4803

台湾地区 - 台北 Tel: 886-2-2500-6610 Fax: 886-2-2508-0102

台湾地区 - 新竹 Tel: 886-3-572-9526 Fax: 886-3-572-6459

亚太地区

澳大利亚 Australia - Sydney Tel: 61-2-9868-6733

Fax: 61-2-9868-6755

印度 India - Bangalore Tel: 91-80-4182-8400 Fax: 91-80-4182-8422

印度 India - New Delhi Tel: 91-11-4160-8631

Fax: 91-11-4160-8632

印度 India - Pune Tel: 91-20-2566-1512

Fax: 91-20-2566-1513

日本 Japan - Yokohama Tel: 81-45-471- 6166

Fax: 81-45-471-6122

韩国 Korea - Daegu Tel: 82-53-744-4301

Fax: 82-53-744-4302

韩国 Korea - Seoul Tel: 82-2-554-7200

Fax: 82-2-558-5932 或 82-2-558-5934

马来西亚 Malaysia - Kuala Lumpur

Tel: 60-3-6201-9857 Fax: 60-3-6201-9859

马来西亚 Malaysia - Penang

Tel: 60-4-227-8870 Fax: 60-4-227-4068

菲律宾 Philippines - Manila

Tel: 63-2-634-9065 Fax: 63-2-634-9069

新加坡 Singapore Tel: 65-6334-8870

Fax: 65-6334-8850

泰国 Thailand - Bangkok

Tel: 66-2-694-1351 Fax: 66-2-694-1350

欧洲

奥地利 Austria - Wels

Tel: 43-7242-2244-39 Fax: 43-7242-2244-393

丹麦 Denmark-Copenhagen

Tel: 45-4450-2828 Fax: 45-4485-2829

法国 France - Paris Tel: 33-1-69-53-63-20

Fax: 33-1-69-30-90-79 德国 Germany - Munich

Tel: 49-89-627-144-0 Fax: 49-89-627-144-44

意大利 Italy - Milan

Tel: 39-0331-742611 Fax: 39-0331-466781

荷兰 Netherlands - Drunen

Tel: 31-416-690399 Fax: 31-416-690340

西班牙 Spain - Madrid Tel: 34-91-708-08-90

Fax: 34-91-708-08-91 英国 UK - Wokingham

Tel: 44-118-921-5869

Fax: 44-118-921-5820

10/05/07